



Solder plus Support

Underfill 620

Underfill

特性:

- 卓越的快速流动性
- 兼容免洗助焊剂残留物
- 没有空洞
- 120°C 可返修
- 良好的存储性能
- 粘度持续

描述:

Underfill 620是一款快速流动的环氧液体，设计用于flip chip、CSP、BGA, 和 uBGA 的细小填充组装。Underfill 620具有减少内部应力，提高热循环性能以及优异的抗化学腐蚀的特点，从而加强了焊点的可靠性。同时，Underfill 620具备高Tg, 低CTE, 填充好，无空洞，兼容免洗助焊剂残留，优异的附着力等特点，提供了特别好的可靠性。通过优异的毛细能力，快速的流动特性和迅速的固化时间，可以得到更高的产能以及更高的良品率。Underfill 620可在120°C时返工。在产品有效期内，Underfill 620的粘度保持稳定。该产品也适用于作为各种裸片的保护。

应用:

- 储存在22°C和 30%RH，底部填充胶620的寿命为12个月。
- 为了获得最佳的应用效果，应将基材先预热到40 - 50°C。尽管不是必需的，但是可以通过预热点胶针头来降低黏度/增加流速。
- 点胶压力应调制适中(15 - 40 psi)。点胶速度也应适中 (0.10 - 0.50 英寸/秒)。此外, 喷涂平台应该能够维持针头离基材表面大约1-3 密耳的距离和距离芯片边缘1-3 密耳。这将最大确保底部填充剂的流动稳定性。
- 对于小芯片 (1/4 ") 的点胶应用，点胶的图形只需要单边或者单角，无需点第二条或者最终补点。因为这个产品低粘度和良好的润湿特性，填充胶会“自动”填充到芯片的另一边。
- 对于大芯片的应用，其点胶模型为典型的“L”型模式，特别是在拐角处。
- 设计的点胶模型应该从距离芯片中心最远的位置开始，这样就能确保底部填充后没有气泡。此外，这种点胶模型可能还需要过点胶延时来增加第二个或第三个点。另外，可能需要增加周边补点来确保芯片周围的应力分布是均匀的。
- Underfill 620通过加热可以返工。返工时，将需要返工的器件加热到标准的温度曲线，然后使用平刮板移除。

固化时间 @ 100°C	固化时间 @ 125°C	固化时间 @ 150°C
<10分钟	< 4分钟	<2 分钟

物理特性:

外观	比重	湿度	总挥发物	25° C (77° F) , 5 RPM 时粘度	流动率测试	TG	可萃取离子含量
红色液体	1.1 g/cc	0.02%	<1%	30,000 cP	~30 secs	~125 °C	<10PPM

*实际流动取决于环境和应用条件.

使用和存储:

温度°C	时间:
25	N/R
4	1 month
≤ -22	6 months

包装:

Underfill 620 不具吸湿性的, 它可以使用注射器、罐、瓶和筒包装。

安全:

- 保持通风并使用适当的个人防护设备。
- 对任何特定的紧急情况, 请参照 MSDS 信息。
- 不要在未核准容器内处理任何有害物质。

加拿大 +1-514-494-2000 · 美国 +1-401-463-5605 · 墨西哥 +52-656-630-0032 · 欧洲 +44-1737-222-259
亚太地区 +86-755-2993-6487 · 印度 +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com

以上信息免费提供, 产品信息根据正确的处理和操作条件提供。所有信息中的焊锡膏由 45 微米焊粉生产而成。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产, 造成的损失或伤害, 不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms.cfm> 查询 AIM 相关条款。